

客户 CUSTOMER:

日期 DATE

纳入仕様书 SPECIFICATION

产 品 名 称 PRODUCT NAME: 微波带通滤波器

Microwave Band-Pass Filter

村 田 料 号 MURATA PART NO.:

敝 司 料 号 OUR PART NO.: MBPF21M3550-N11

版 本 号 VERSION.: V1.1

接受 RECEPTION

THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED.

该纳入仕様书已被我司接受

日期:
DATE:

公司:
COMPANY:

批准
CFMD

审核
CHKD

接收
RCVD

本纳入仕様书共 7 页

MANUFACTURING NAME

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD

TEL: 86-755-28085000

FAX: 86-755-28085605

CFMD. 批准	CHKD. 审核	DSGD. 担当
梁启新	付迎华	曾艳峰

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

纳入仕様书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

ver.	DATE	CONTENT	APPROVED
1.0	2018.07.06	初稿 Constitute	梁启新
1.1	2020.10.23	增加功率容量 Add Power Capacity	付迎华

目录 CATALOG

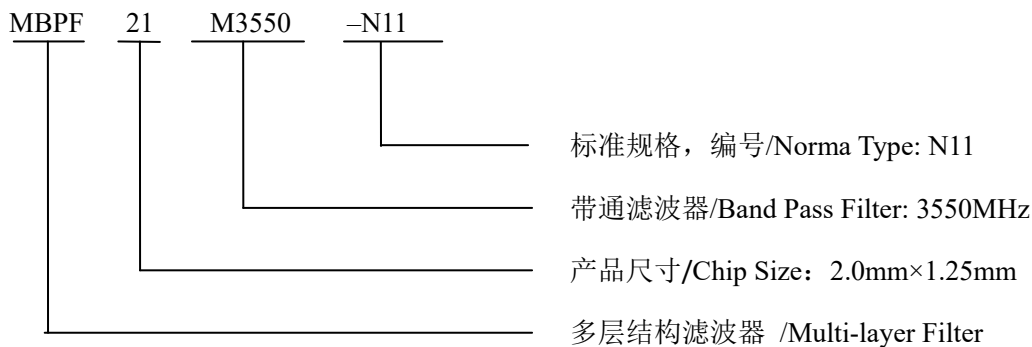
1	适用范围 Scope.....	4
2	品名构成 Product Identification.....	4
3	形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material.....	4
4	测试条件 Testing Conditions.....	5
5	电气性能 Electrical Characteristics	5
6	特性曲线 Characteristic Curve	6
7	焊接条件 Recommended Soldering Conditions	7

1 适用范围 Scope

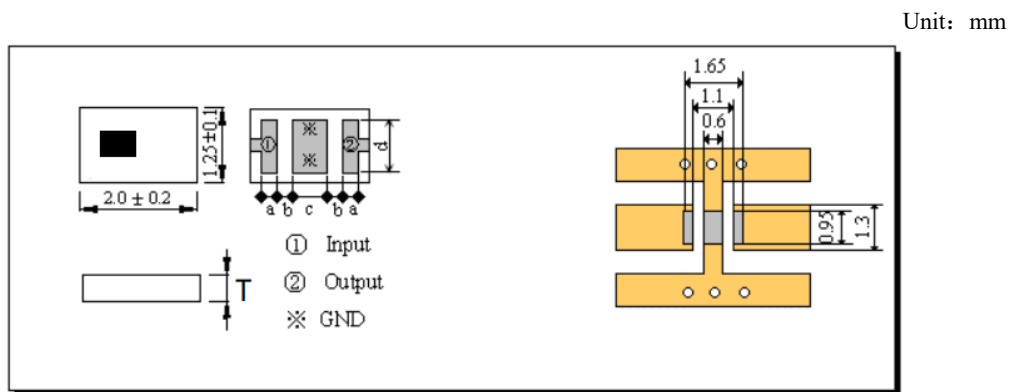
“麦捷”微波带通滤波器系列产品设计用于 WIFI、GSM、Bluetooth、PDA 和无绳电话机中，具有低的插入损耗、高的衰减和小体积 SMD 片式设计，能减少复杂的调校工作，可以简化电路设计。

“Microgate” Microwave Band-Pass filter series are designed to be used in WLAN、GSM、Bluetooth、PDA & cordless phones with low insertion loss and high attenuation as well as small size SMD chip design , which can simplify your complex tuning and circuit design .

2 品名构成 Product Identification



3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material



标识 Mark	尺寸 Size(mm)
T	0.7max
a	0.275±0.1
b	0.25±0.05
c	0.6±0.1
d	0.95±0.1

Part Name 名称	Structure and Material 结构及材料
Resonator 谐振体	Dielectric Material LTCC 介质材料
In/Output Terminals 输入/输出	Ag 银
Ground Base 接地面	Ag 银

4 测试条件 Testing Conditions

除非另有规定，否则在以下条件下测试 <Unless otherwise specified>

温度 Temperature : Ordinary Temperature (-40 to 85°C)

湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH)

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

当对测量结果有疑问时<In case of doubt>

温度 Temperature : 20±2°C

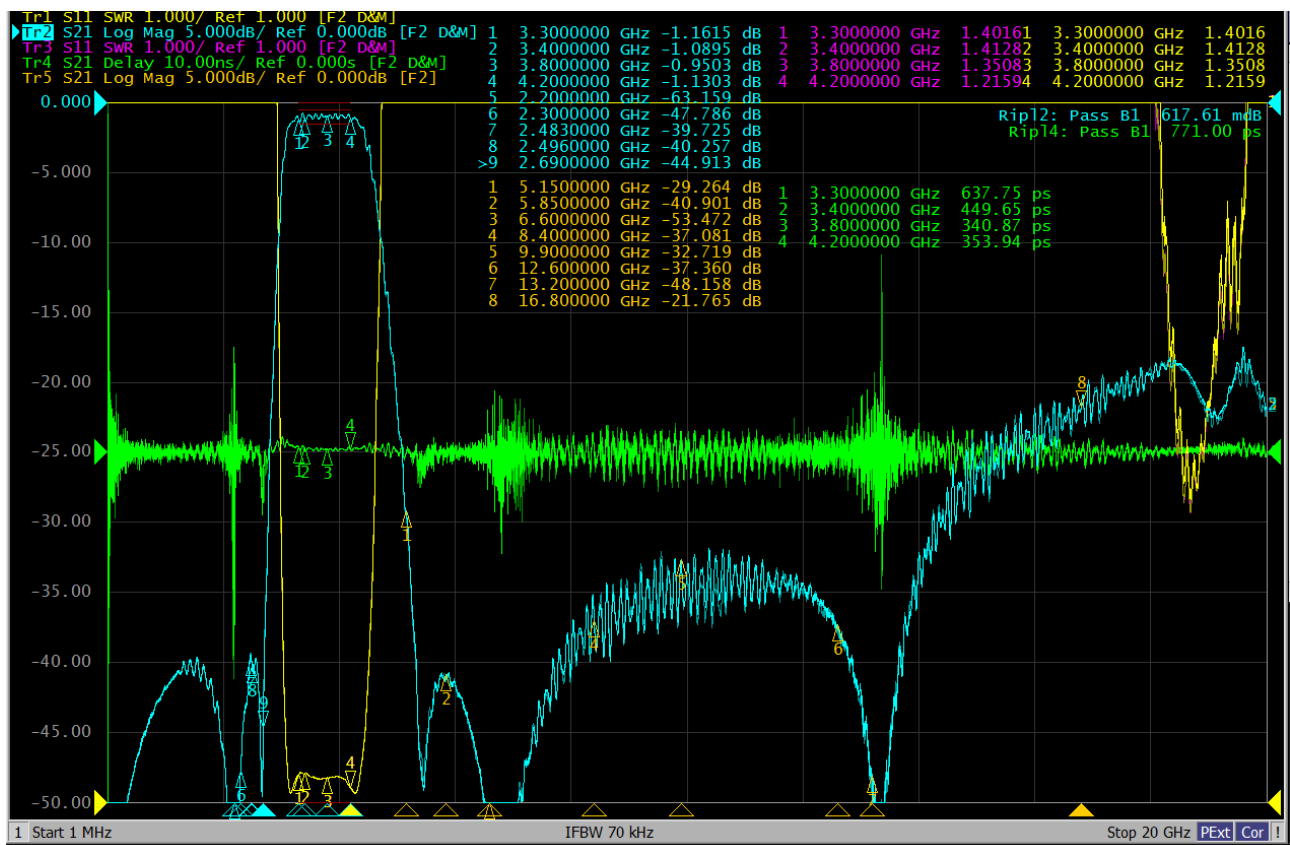
湿度 Humidity : 60 to 75% RH

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

5 电气性能 Electrical Characteristics

参数 Parameter	符号 Symbol	需求规格 Spec Requirement			备注
		下限值 Min	典型值 Typ	上限值 Max	
Frequency Range	MHz	3300		4200	
Insertion loss(dB)	3300-3500MHz	/	1.2	2.25	全温(full temp)
	3500-4200MHz	/	1.2	2.25	全温(full temp)
	3300-3800MHz	/	1.2	2.25	全温(full temp)
	3400-3800MHz	/	1.0	2.25	全温(full temp)
	3300-4200MHz	/	1.2	2	常温(25°C)
	3300-3800MHz	/	1.2	2	常温(25°C)
	3400-3800MHz	/	1.0	1.5	常温(25°C)
Input port impedance	Ohm	/	50	/	-10~85°C
Output port impedance	Ohm	/	50	/	
VSWR (in/out)	/		1.3	2.1	
Absolute attenuation(dB)	450-2200MHz	36	/	/	
	2300-2483MHz	38	/	/	
	2496-2690MHz	33	/	/	
	5150-5850MHz	25	/	/	
	6600-8400MHz	25	/	/	
	9900-12600MHz	15	/	/	
	13200-16800MHz	15	/	/	
Power Capacity				40dBm	

6 特性曲线 Characteristic Curve



深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址：深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

6

7 焊接条件 Recommended Soldering Conditions

1、焊剂 Flux, Solder

① 使用松香助焊剂，禁止使用卤化物含量超过 0.2wt% 的强酸性助焊剂。

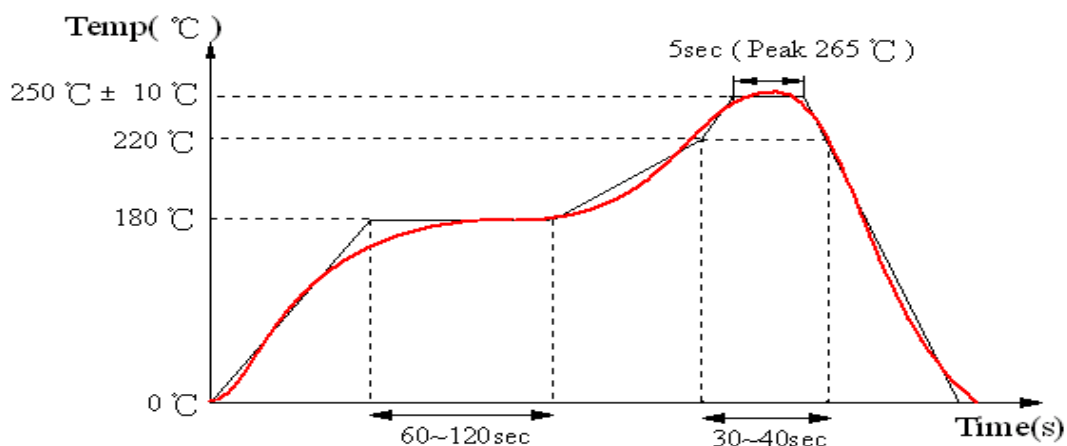
Use rosin-based flux. Don't use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value).

② 使用纯锡焊料 Use Sn solder.

2、回流焊条件 Reflow soldering conditions

● 预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃，焊接完后冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹，导致产品品质下降。

Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality.



● 标准回流焊曲线 Standard soldering profile.

3、手工返工 Reworking with soldering iron

当使用电烙铁进行手工焊接时，以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron.

预热 Pre-heating	150°C, 1 minute
尖端温度 Tip temperature	350°C max
输出功率 Soldering iron output	80w max
电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron	φ3mm max
焊接时间 Soldering time	3 seconds max